

2006年1月30日

## 住友金属鉱山パッケージマテリアルズ株式会社をワイヤボンドタイプ CSP 基板に関する特許権侵害で提訴

日立化成工業株式会社（本社：東京、執行役社長：長瀬寧次、資本金 153 億円）は、住友金属鉱山パッケージマテリアルズ株式会社に対し、同社の 1ワイヤボンドタイプ CSP(Chip Size Package)基板が、当社の保有する特許権 3 件を侵害するものとして、2006 年 1 月 24 日、その製造、販売の差し止め並びに損害賠償を求め、東京地方裁判所に提訴いたしました。

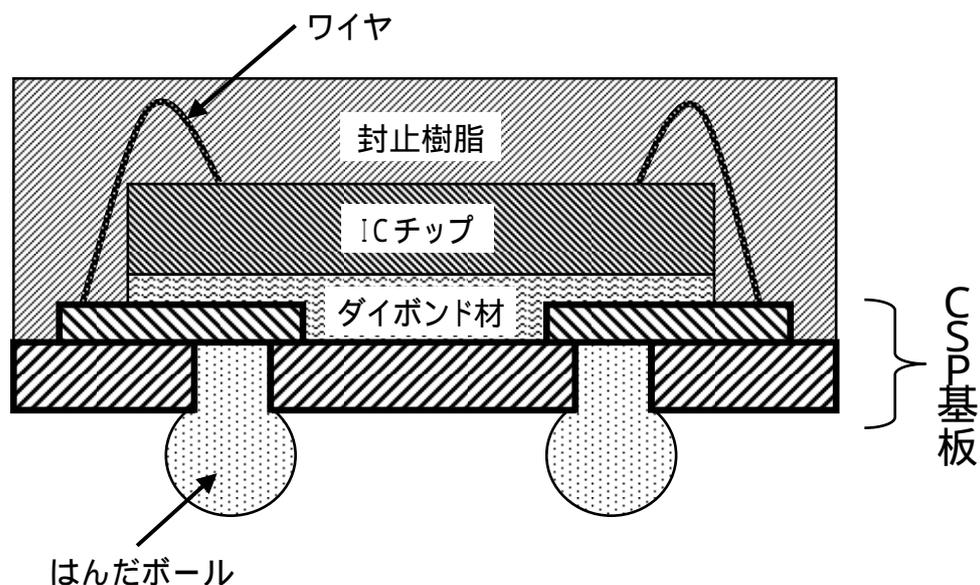
当社は住友金属鉱山パッケージマテリアルズ株式会社と 2004 年から問題解決に向けての協議を続けて参りましたが、合意に至らなかったため、今般、止むを得ず提訴の判断をいたしました。

当社は 1996 年にワイヤボンドタイプの CSP 基板を開発して以来、現在に至るまで複数の特許を権利化しております。今後も、他社の知的財産を尊重すると同時に、当社の権利を侵害する行為に対しては毅然とした態度で臨み、知的財産の保護を図って参ります。

1ワイヤボンドタイプ CSP (Chip Size Package) 基板

IC チップとほとんど同等の大きさに封止したパッケージ (Chip Size Package) に用いられる、IC チップの回路と配線部をワイヤボンドで接続する方式の、IC チップ搭載用基板。

### 当社特許を使用した CSP 基板を用いたパッケージの一例 断面の模式図



(報道関係お問い合わせ)

日立化成工業株式会社 コーポレート戦略室 広報担当 長谷川、金成 TEL 03-5381-2374